

锦州神工半导体股份有限公司 关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加向金融机构申请授信额度人民币 4.5 亿元。本次增加申请授信额度后，公司可向金融机构申请总额不超过 8 亿元的授信额度。现将相关事项公告如下：

一、原审批的申请授信额度情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意公司向金融机构申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

二、本次申请增加授信额度情况

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司拟在原审议通过的申请综合授信额度基础上增加向金融机构申请综合授信额度人民币 4.5 亿元。本次增加申请综合授信额度后，公司可向金融机构申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度。该综合授信额度的有效期延长至自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在综合授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，实

际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信类型包括但不限于：远期结售汇、贷款、贸易融资、融资租赁、票据承兑、进出口押汇、进出口代付、开出信用证等业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。

公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《中华人民共和国公司法》相关规定及《锦州神工半导体股份有限公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。

为提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，董事会同意授权公司管理层指定的授权代理人在上述额度和期限范围内全权办理向银行申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日